



2026 HIGHLIGHTS

全产业链覆盖：展览面积超10万平方米、1,500家展商、5,000多个展位，20多场同期会议和活动。这是一个覆盖芯片设计、制造、封测、设备、材料、光伏、显示等全产业链携手合作，全球规模最大、最具影响力的盛宴！

最高规格：开幕主题演讲汇集全球行业领袖，演讲嘉宾们在现场和大家分享全球产业格局、前沿技术与市场走势。

聚焦市场热点的技术论坛：“2026全球半导体产业战略峰会（ISS）：SEMI产业创新投资论坛（SIIP China）”、“化合物半导体”、“AI智能应用和汽车芯片”、“智能制造”、“先进材料”、“异构集成（先进封装）”、“AI瞰视界：显示双引擎OLED+Micro LED”等主题论坛覆盖半导体全产业链。集成电路科学技术大会（CSTIC）更是结合产学研的中国最具影响力的国际微电子技术论坛。

主题展区把握泛半导体产业脉搏：结合中国半导体产业特点和全球半导体产业发展趋势，SEMICON China 2026覆盖了市场热点主题，包括IC制造、化合物半导体、Micro-LED和SEMI中国英才计划。



观众注册信息

参观数	200,068
SEMICON/FPD China 观众	142,281
SEMICON/FPD China 参展商	57,787

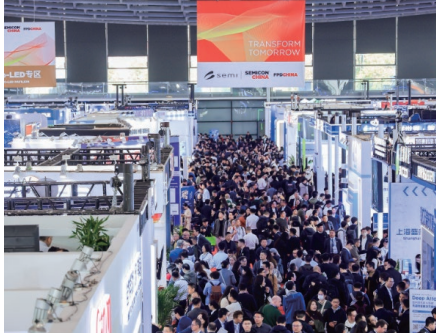
境外观众信息

SEMICON China/FPD China 境外观众数		7,808	
中国台湾	25%	韩国	28%
日本	17%	新加坡	6%
其他	7%	俄罗斯	4%
马来西亚	4%	中国香港	4%
美国	3%	德国	2%



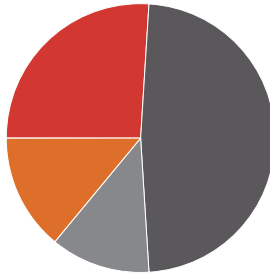
观众概述

SEMICON/FPD China 吸引了全球微电子行业各个环节极富影响力的观众，包括半导体、LEDs、OLEDs、MEMS、柔性电子和其他相关市场。



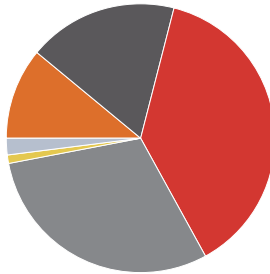
具有影响力的买家

观众采购影响力



- 25% 最终决策者/共同决策者/关键决策者
- 49% 推荐人/为决策者提供信息或评估/咨询
- 13% 具体说明者
- 13% 非采购角色/其他

工作职位



- 11% 执行级管理人员
- 17% 高级管理人员
- 38% 其他管理人员
- 31% 非管理人员
- 2% 学生
- 1% 其他



观众主要职能

SEMICON / FPD China 吸引了各个不同级别、不同职能和不同行业的买家团队。

研究开发	15%
设计	6%
设备工程	5%
产品管理	6%
制造工艺	5%
测试	3%
封装/组装工艺	3%
化学/材料	2%
设施/工程支持	2%
质量保证/故障分析/可靠性	2%
工业工程	1%
软件工程	1%
市场营销/销售/业务开发	19%
采购/办公管理	6%
财务/产业分析/投资人关系	5%
制造/运营管理/生产	3%
执行董事/董事会成员	3%
物流/供应链管理	3%
政府/公共政策	2%
集成/技术支持	<1%
人力资源	<1%
环境、健康和安全(EHS)	<1%
培训/教育	<1%
其他	7%



观众关注领域

SEMICON / FPD China 的观众对从设计到最终制造的整个产业链技术和产品都感兴趣。

观众关注的技术类别

半导体	42%
MEMS	9%
传感器	13%
影像	5%
柔性混合电子/ 印刷电子	5%
LED/固态照明	6%
光电	13%
平板显示	9%
太阳能光伏	9%
软件/应用	5%
消费电子	9%
印刷电路板制造	6%
印刷电路板组装	4%
电子制造服务/代工/精密工程	10%
汽车/交通	6%
医疗	6%
航天航空	6%
专业服务/咨询服务	5%
学术界/大学/研发	4%
媒体/出版	1%
协会/非营利组织	1%
政府	3%
其他	4%

观众关注领域

制造技术

设计/电子设计自动化/IP类软件	37%	材料工程/材料科学	34%
前端制造 (IDM, 晶圆厂)	50%	系统级制造	17%
测试	39%	板级制造	11%
封装/组装工艺	44%	系统集成/产品级制造	18%
软性电子Roll-to-Roll	8%	其他制造	15%

感兴趣的应用

智能制造	38%	移动技术/无线/5G	12%
虚拟现实/增强现实(VR/AR)	26%	消费电子	22%
人工智能系统(AI)	46%	OLED	12%
汽车电子/智能交通	27%	绿色制造/安全管理	9%
物联网 (IoT)	17%	云计算/高性能计算	12%
可穿戴设备	19%	成像	7%
医用电子/医学科技	14%	其他应用	14%

感兴趣的产品/服务

设计/制造服务

设计/电子设计自动化(EDA)	33%	工艺控制/工艺软件	17%
无晶圆半导体	26%	制造服务及咨询	20%
晶圆厂	44%	工程服务	14%
封装测试服务(OSAT)	37%	电子设计自动化/技术转化	11%
电子制造服务(EMS)/系统集成	17%	其他设计/制造服务	15%

制造设备

前道处理设备	21%	工厂自动化/机器人	19%
印刷/涂层/Roll-to-Roll	14%	治理/环境系统	6%
Large-area/薄膜	19%	部件/子系统/仪表	10%
检验和测试/计量	18%	零部件	18%
测试设备	28%	二手设备及服务	8%
封装设备	30%	其他制造设备	16%

材料

晶圆/硅衬底	47%	封装材料	26%
加工材料: 气体/液体/固体材料/化工品	31%	耗材	10%
墨水/糊剂/印刷材料	10%	其他材料	18%
清洁材料	14%		

其他

支持产品/无尘室	20%	标准	7%
一般商业服务/咨询	13%	其他	17%
销售代表及服务	15%		



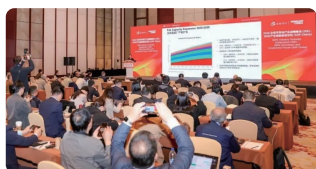
2026 POST-SHOW REPORT

Co-located with
FPDCHINA

同期研讨会观众数



开幕主题演讲 **1332**



全球半导体产业战略峰会 (ISS): SEMI产业创新投资论坛 (SIIP China) **303**



设计创新论坛: AI智能应用和汽车芯片 **384**



SEMI中国英才计划领袖峰会 **201**



SCC 可持续发展与ESG高峰论坛 **125**



异构集成(先进封装)国际会议: AI算力与CPO **525**



亚洲化合物半导体大会 **405**



IC 制造产业链国际论坛 - 晶圆制程与设备 **303**



先进材料国际论坛 **215**



半导体智能制造 - 未来工厂 **292**



绿色厂务国际创新论坛 **189**



新技术发布会 **491**



中国显示大会- AI瞰视界:显示双引擎 OLED+Micro LED **218**



集成电路科学技术大会(CSTIC) **1024**

See You Next Year

March 24 - 26
2027
Shanghai, China